

证券代码：002845

证券简称：同兴达

公告编号：2021-071

深圳同兴达科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况：

为满足公司战略发展需要，近日深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）与日月光半导体（昆山）有限公司（以下简称“昆山日月光”）签订了《项目合作框架协议》，公司拟在昆山投资设立全资子公司昆山同兴达半导体有限责任公司（名称暂定，以下简称“同兴达半导体”），注册资金为 7.5 亿元人民币。用来实施“芯片金凸块（Gold Bump）全流程封装测试项目”（简称“Gold Bump 封测”）项目，有助于公司向产业链前端领域延伸布局，提升公司的综合性竞争力。

2、董事会审议投资议案的表决情况：此次董事会通知于 2021 年 9 月 30 日以书面及通讯方式发出，董事会于 2021 年 10 月 14 日召开，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，表决结果以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过本议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

3、是否构成关联交易：本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资设立子公司的基本情况

1、出资方式：以现金方式出资；

2、资金来源：公司自有或自筹资金；

3、投资方的基本情况：

企业名称：深圳同兴达科技股份有限公司；

企业住所：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301-72 号银星智界 2 号楼 1301-1601；

企业类型：股份有限公司；

法定代表人：万锋；

注册资本：23431.4304 万元人民币；

主营业务：一般经营项目是：电子产品的技术开发、生产及销售；国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）；

4、标的公司基本情况：

公司名称：昆山同兴达半导体有限责任公司（暂定，具体以工商核定为准）；

企业类型：有限责任公司；

住所：江苏省昆山市千灯镇（暂定）；

法定代表人：万锋（暂定）；

注册资本：7.5 亿人民币；

投资人的投资规模和持股比例：由公司出资 7.5 亿元人民币独资设立，持股比例 100%；

同兴达半导体的经营范围：从事半导体科技、集成电路领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子元器件、电子产品、计算机软件及辅助设备的销售，计算机系统集成，货物或技术进出口（暂定，具体以工商核定为准）。

5. 项目情况

项目名称：昆山同兴达半导体有限责任公司（暂定，具体以工商核定为准）

项目投资的具体内容：打造全流程 Gold Bump（金凸块）+CP 测试+COF/COG

（一期）

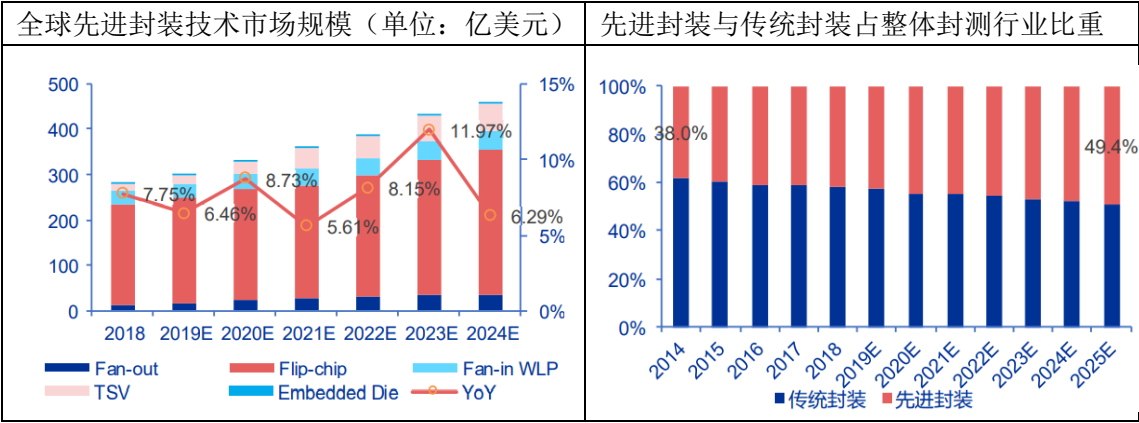
投资总额及进度：待股东大会审议通过后，按照“芯片金凸块（Gold Bump）全流程封装测试项目”总投资金额，双方分别出资，具体投资金额及出资比例以双方后续实际合作及项目进度情况为准。

项目投资领域基本情况：公司与昆山日月光为充分发挥各自优势，公司特投资设立子公司，共同合作“芯片金凸块（Gold Bump）全流程封装测试项目”，芯片封装位于芯片制造产业链后端。目前传统封装面临诸多瓶颈、先进制程逼近物理极限，而先进封装可以相对容易的实现芯片的高密度集成、体积的微型化和更低的成本。

Gold Bump 封测项目投资的可行性分析：

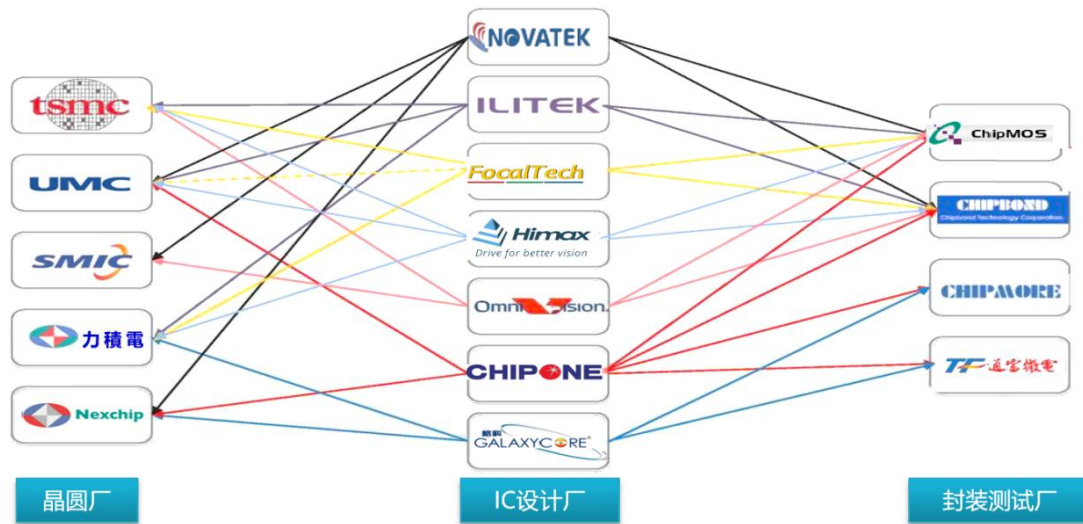
（一）先进封测领域市场空间广阔，目前为最佳进入时机

先进封装尤其是倒装芯片市场规模广阔。根据 Yole 预测，2025 年先进封装的占比将提升至整体封测行业的 49.4%，其中倒装为先进封装中最大市场。2018 年先进封装市场规模约为 280 亿美元，其中倒装市场规模约 224 亿美元，占比达 80%，2018-2024 年的 CAGR 为 6%。



数据来源：Yole

中国大陆 Gold Bump 封测产能较少，目前是进入此细分市场的最佳时机。全球芯片市场主要 IC 设计、晶圆代工、封测厂商如下图：



（二）合作方昆山日月光提供技术支持

先进封装金凸块生产过程涉及 UBM 镀膜和光刻等高难度工序，不但需要根据产品制程特点购买配套设备，并需要由专业团队进行调试和试产，在此过程中特定设备需要持续运行和投入，如果没有专业可靠的技术团队，前期会耗费大量的时间与资源。本次项目选择日月光半导体负责技术与人员事项，日月光在全球封测市场市占率长期位居第一，具有丰富、成熟的技术和项目经验，可最大程度保证快速量产和稳定产品良率。

（三）公司显示模组业务为产品提供市场验证支持，保障订单充足

芯片封测前期需要试产验证，项目投产后，公司可利用其驱动 IC 下游应用的市场优势，协同封测厂进行制造工艺、技术参数的进一步调试，争取在尽量短时间内完成验证并做量产。通过公司的批量采购和市场验证，逐渐形成市场口碑，有助于其他客户的开拓。

同时，公司长期与全球主流驱动 IC 设计厂商有大量采购驱动 IC 的业务往来，有较好的合作基础，满足要求的封测产线建成后有望拿到这些企业的大量订单。

最后本次投资资金为公司自有资金及自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、对外投资的目的：

本次公司投资设立子公司主要用于实施先进封测项目，契合同兴达的战略发

展规划，有助于公司向产业链前端领域延伸布局，开阔新的业绩增长点，从而提高公司综合竞争力，提升经营效益与盈利水平。其次封测项目与公司主营业务具有协同效应，公司主营显示模组和光学摄像模组，原材料包括驱动 IC 和 CIS 芯片。封测项目可加强与上游芯片企业联系，一定程度保障模组业务的芯片供应，同时可降低部分采购成本，增强公司盈利能力。

2、对外投资对公司的影响

本次新设全资子公司，是结合公司现有的产业基础和竞争实力，为了进一步实现产品升级和拓展公司新业务领域，提高公司核心竞争力，满足市场及客户需求，服务于公司未来发展战略需要。本次对外投资设立全资子公司符合上市公司全体股东的长远利益，不会对公司的发展战略造成不利影响，而且本次投资以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

3、对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资子公司事项尚需提交当地工商行政管理部门登记/核准，具有一定的不确定性。公司能够对标公司实施有效控制，但未来经营受到政策环境、市场环境等多方面因素的影响。

公司会加强对行业经济、产业政策的研判，密切关注该子公司的经营管理，组建良好的经营管理团队，督促其规范运作，加强风险控制，力争达到预期设想的战略目标。相关事项若有后续重大进展或变化，公司将依照有关监管规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 14 日